第四章 平衡状态下的半导体

第一节 半导体能带结构

半导体能带特点: T=0K时,最高能带满,以上空。 $T\neq 0$ K,电子激发跃迁

结果:最高能带出现空位(空穴)上面空带有电子

由价电子填充 价带 Ev

由激发电子填充导带Ec

一、E(K)与 K 的关系 实际应用,只要考虑能带极值附近的关系 设导带底位于 K=0

$$E(\mathbf{K}) = E_{c}(0) + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial^{2} E}{\partial K_{x}^{2}} \right)_{\mathbf{K}=0}^{2} K_{x}^{2} + \left(\frac{\partial^{2} E}{\partial K_{y}^{2}} \right)_{\mathbf{K}=0}^{2} K_{y}^{2} + \left(\frac{\partial^{2} E}{\partial K_{z}^{2}} \right)_{\mathbf{K}=0}^{2} K_{z}^{2} \right]$$

$$= E_{c}(0) + \frac{\hbar^{2}}{2} \left(\frac{K_{x}^{2}}{m_{x}^{*}} + \frac{K_{y}^{2}}{m_{y}^{*}} + \frac{K_{z}^{2}}{m_{z}^{*}} \right)$$

$E_c(0)$ 导带底的能量

$$\frac{1}{m_x^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial K_x^2} \right)_{K=0}$$

$$\frac{1}{m_y^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial K_y^2} \right)_{K=0}$$

$$\frac{1}{m_z^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial K_z^2} \right)_{K=0}$$

各向同性的晶体 K=0

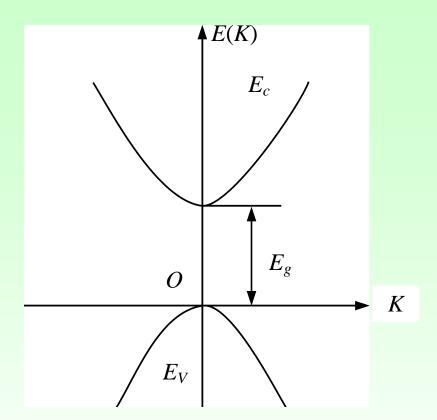
$$m_{x}^{*} = m_{y}^{*} = m_{z}^{*} = m_{n}^{*}$$

$$E(\mathbf{K}) = E_{c}(0) + \frac{\hbar^{2}}{2m_{n}^{*}} (K_{x}^{2} + K_{y}^{2} + K_{z}^{2})$$

$$= E_{c}(0) + \frac{\hbar^{2}K^{2}}{2m^{*}}$$

$$E(K) = E_c(0) + \frac{\hbar^2 K^2}{2m_n^*}$$

$$E(\mathbf{K}) = E_{v}(0) - \frac{\hbar^{2}K^{2}}{2m_{p}^{*}}$$



二、K空间等能面

等能面: R空间能量相同的点构成的曲面

$$\frac{K_{x}^{2}}{2m_{n}^{*}[E(\mathbf{K})-E_{c}(0)]} + \frac{K_{y}^{2}}{2m_{n}^{*}[E(\mathbf{K})-E_{c}(0)]} + \frac{K_{z}^{2}}{2m_{n}^{*}[E(\mathbf{K})-E_{c}(0)]} = 1$$

$$\hbar^{2}$$

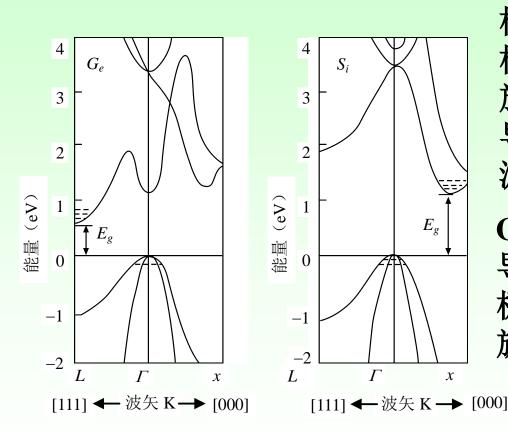
半径: $\sqrt{(2m_n^*/\hbar^2)[E(K)-E_c(0)]}$ 的球面。

各向异性的晶体,能带极值K=0

$$E(\mathbf{K}) = E_c(\mathbf{K}_0) + \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{\left(K_x - K_{0x}\right)^2}{m_x^*} + \frac{\left(K_y - K_{0y}\right)^2}{m_y^*} + \frac{\left(K_z - K_{0z}\right)^2}{m_z^*} \right]$$

三、常见半导体的能带结构

1、硅和锗的能带结构



导带

Si:

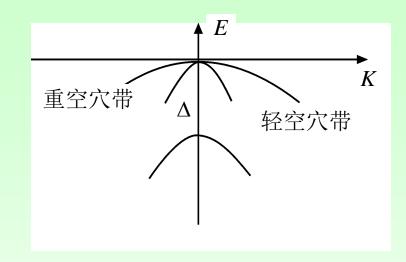
极小值在<100>六个等价方向上, 极值附近等能面为沿<100>方向 旋转的旋转椭球面, 导带极值位于<100>方向的布里 渊区中心到边界的0.85倍处。

Ge:

导带极小值在<111>布区边界, 极值附近等能面为沿<111>方向 旋转的8个旋转椭球面。

价带

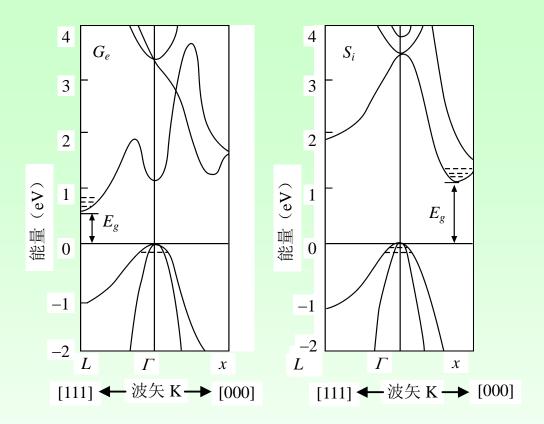
价带顶位于K=0,有三个带。两个最高的在K=0 处简并,重空穴带(曲率小)、轻带空穴(曲率大)。另一带由自旋-轨道耦合分裂出



$$E(\mathbf{K}) = E_{v} - \frac{h^{2}}{2m_{0}} \left\{ AK^{2} \pm \left[B^{2}K^{2} + C^{2} \left(K_{x}^{2}K_{y}^{2} + K_{y}^{2}K_{z}^{2} + K_{z}^{2}K_{x}^{2} \right) \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

特点: a.同一K,有两个能量,极大值在K=0处重合b.有效质量两个,取负-重空穴,取正-轻空穴等能面是扭曲面

- c.第三个能带能量降低了 Δ ,等能面接近球面
- d.导带底和价带顶K值不同
- e.禁带宽度随温度变化



导带底和价带顶不在 *K* 空间的相同点,具有这种能带特点的半导体称为间接带隙半导体。

2、III-V族化合物半导体的能带结构

1) 砷化镓

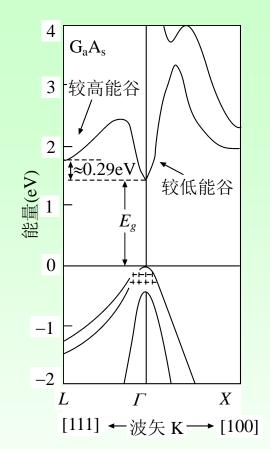
导带:

极小值位于k=0处,等能面是球面 <111>方向的极小值比布区中心极 小值约高 0.29ev

价带:

三能带组成 重空穴带极大值偏离K=0,但很少

导带底和价带顶在 K 空间的相同点,具有这种能带 特点的半导体称为直接带隙半导体。



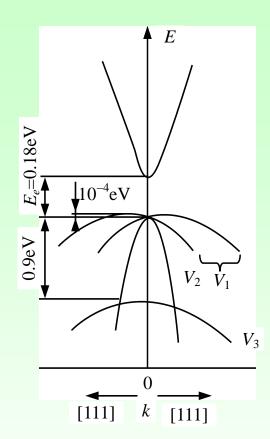
2) 锑化铟

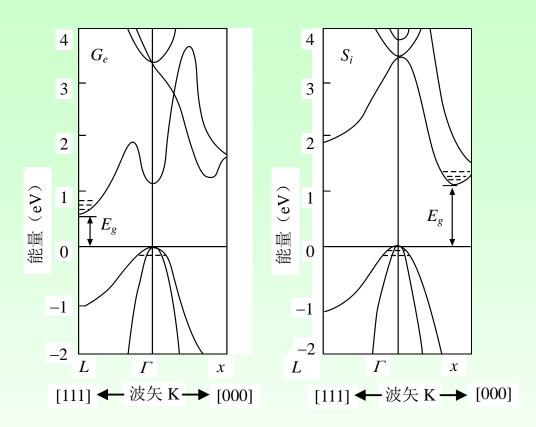
导带:

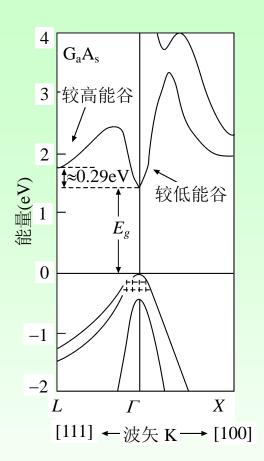
极小值位于k=0处,等能面是球面 底电子有效质量很小

价带:

三能带组成 重空穴带极大值偏离K=0,但很少 直接带隙半导体







第二节 本征半导体和杂质半导体

- 一、本征半导体极其导电机构
- 1、实际半导体中的偏离
- •原子在平衡位置附近振动
- •存在其它化学原子
- •存在缺陷 (周期势性被破坏)
- 3、导电机构
- •载流子: 电子、空穴
- •价带中电子热激发到导带, 电场下,空穴(价) 电子(导)导电

- 2、本征半导体特点
- •无杂质原子
- •无缺陷 (严格周期性)

4、本征半导体条件

$$n = p = n_i$$

电中性条件

二、杂质半导体及其导电机构

实际半导体中有杂质,还存在缺陷 由于杂质、缺陷存在,使严格周期受到破坏, 在禁带中引入能带状态。

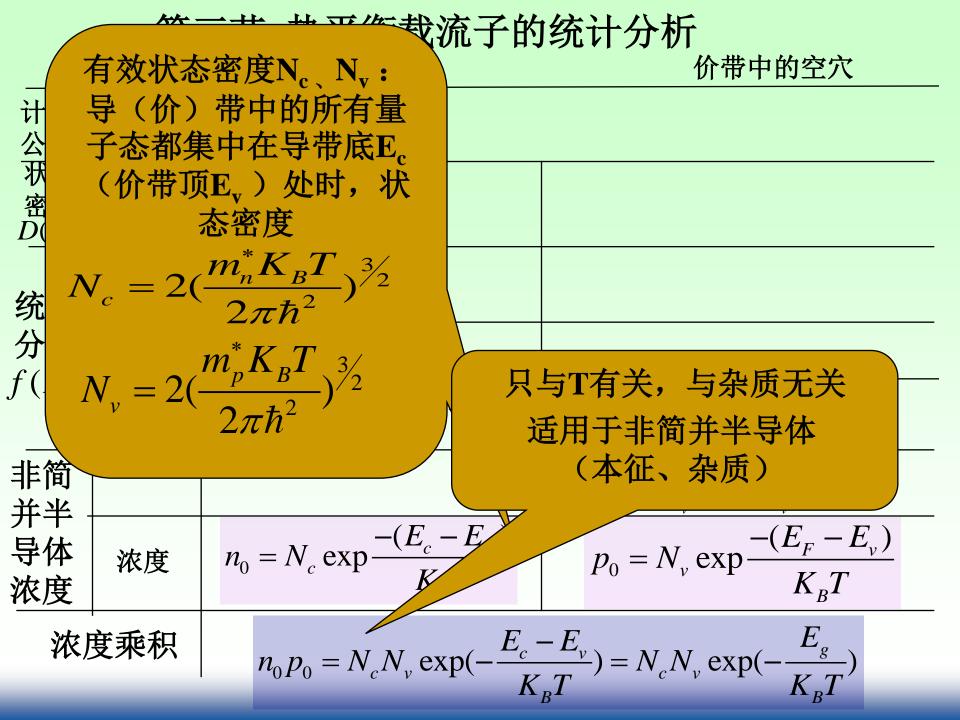
按杂质作用不同分为施主杂质和受主杂质

		施主	受主	
杂质		V族(P)	Ⅲ族(B)	
	载流子	电子	空穴	
导电	机制	杂质电离-电子跃迁	杂质电离-空穴-跃迁	
	杂质电离能	$\Delta E_D << E_g$	$\Delta E_A << E_g$	
	浅能级 电离能	$\Delta E_D = \frac{m_n^* q^4}{8\varepsilon_r^2 \varepsilon_0^2 h^2} = \frac{m_n^*}{m_0} \cdot \frac{E_0}{\varepsilon_r^2}$	$\Delta E_A = \frac{m_p^* q^4}{8\varepsilon_r^2 \varepsilon_0^2 h^2} = \frac{m_p^*}{m_0} \cdot \frac{E_0}{\varepsilon_r^2}$	
能级	位置	比 E _c 低Δ E _D ,接近 E _c	比 E_v高ΔE_A,接近E_v	
	特点	独立能级,短线表示	独立能级,短线表示	
	图式	E_{g}	E_{C} E_{D} E_{S} AE_{A} E_{D} E_{C} E_{D} E_{V}	

		施主	受主
半导体类型		电子型,n型	空穴型,P型
杂质补	条件	$N_D >> N_A$	$N_A >> N_D$
偿作用 (施主与	有效浓度	$N_D - N_A$	$N_A - N_D$
受主杂质之间相互	用途	改变某区	域导电类型
抵消的作用)	图式	$E_{D} \stackrel{\uparrow}{\uparrow} \stackrel{\uparrow}{\downarrow} \stackrel{\uparrow}{\downarrow} \stackrel{\uparrow}{\downarrow} \stackrel{\uparrow}{\downarrow} \stackrel{\downarrow}{\downarrow} \stackrel{\downarrow}{\downarrow$	
	高度 补偿	条件: N _D ≈N _A	实质:杂质多,但不 能提供电子或空穴

第三节 热平衡载流子的统计分析

	导带中的电子		价带中的空穴
计算 公式	$n_0 = N/V \qquad N = \int_0^E f(E)$		$p_0 = N/V$
状态 密度 D(E)	$\left(\frac{V}{2\pi^2}\right)$	\hbar^3) $(2m_n^*)^{3/2}(E-E_c)^{1/2}$	$\left (\sqrt[V]{2\pi^2 \hbar^3}) (2m_p^*)^{\frac{3}{2}} (E_V - E)^{\frac{1}{2}} \right $
统计 分布 f(E)		$f(E) = 1/\left[\exp(\frac{E - E_F}{K_B T}) + 1\right]$	$1 - f(E) = 1 / \left[\exp(\frac{E_F - E}{K_B T}) + 1 \right]$
	非简并 (波-兹)	$f_B(E) = A \exp(-E/K_B T)$	$1 - f_B(E) = B \exp(E/K_B T)$
	实例	n型半导体掺杂少时, 导带电子少	p型半导体掺杂少时, 价带空穴少
非治等体	积分限	$\int_{E_c}^{E_c'} \implies \int_{E_c}^{\infty}$	$\int_{E_{ u}}^{E_{ u}'} \implies \int_{E_{ u}}^{\infty}$
	浓度	$n_0 = N_c \exp \frac{-(E_c - E_F)}{K_B T}$	$p_0 = N_v \exp \frac{-(E_F - E_v)}{K_B T}$
浓度乘积		$n_0 p_0 = N N \exp(-\frac{E_c}{N})$	$\frac{-E_{v}}{N} = N N \exp(-\frac{E_{g}}{N})$



五、本征半导体的载流子浓度

1、本征费米能级

$$n_{0} = p_{0}$$

$$N_{C} \exp(-\frac{E_{C} - E_{F}}{K_{B}T}) = N_{V} \exp(-\frac{E_{F} - E_{V}}{K_{B}T})$$

$$E_{F} = E_{i} = \frac{E_{C} + E_{V}}{2} + \frac{K_{B}T}{2} \ln \frac{N_{V}}{N_{C}}$$

$$E_{i} = \frac{E_{C} + E_{V}}{2} + \frac{3K_{B}T}{4} \ln \frac{m_{p}^{*}}{m_{s}^{*}}$$

硅、锗、砷化镓的第二项小得多,所以本征半导体的费米 能级基本上在禁带中央处 。

2、本征载流子浓度

$$n_i = n_0 = p_0 = (N_C N_V)^{1/2} \exp(-\frac{E_g}{2K_B T})$$
 温度

掺杂且 $n_0 p_0 = N_C N_V \exp(-\frac{E_g}{K_B T})$ 比较 $n_0 p_0 = n_i^2$

非简并半导体热平衡 载流子浓度乘积

本征载流子 浓度平方

与杂质无关



适用本征半导体材料、非简并的杂质半导体材料

将 N_C , N_V \hbar 和 K_B 代入,且考虑Eg随温度变化:

$$n_i = n_0 = p_0 = (N_C N_V)^{1/2} \exp(-\frac{E_g}{2K_B T})$$

$$\ln n_i = 常数 \frac{3}{2} \ln \frac{1}{T} - \frac{E_g(0)}{2K_B} \frac{1}{T}$$
随T变化缓慢,可忽略

是 1/T

的函数

本征半导体: n₀, p₀随T迅速变化,器件性能不稳定。

杂质半导体: $T_{\text{杂质电离}} < T < T_{\text{本征电离}}$, 载流子主要来源于杂质电离,若杂质全电离, n_0 , p_0 一定,器件就能稳定工作。

六、杂质半导体的载流子分布 施主能级不能同时被自旋相反的两个电子占据, 不能用费米分布函数来表示杂质能级被占据的几率

1、载流子占据杂质能级的几率

电子占据施主能级的几率

$$f_D(E) = \frac{1}{\frac{1}{2} \exp(\frac{E_D - E_F}{K_B T}) + 1}$$

空穴占据受主能级的几率

$$f_A(E) = \frac{1}{\frac{1}{2} \exp(\frac{E_F - E_A}{K_B T}) + 1}$$

电子未占据施主能级的几率

$$1 - f_D(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E_F - E_D}{K_B T})}$$

空穴未占据受主能级的几率

$$1 - f_A(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E_A - E_F}{K_B T})}$$

2、杂质能级上的杂质浓度 n_D 施主能级上电子浓度 n_D

受主能级上空穴 PA

$$n_D = N_D f_D(E) = \frac{N_D}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E_D - E_E}{K_B T})}$$

$$p_A = N_A f_A(E) = \frac{N_A}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E_F - E_A}{K_B T})}$$

电离施主浓度 パム

$$n_D^+ = N_D - n_D = N_D [1 - f_D(E)] = \frac{N_D}{1 + 2 \exp(\frac{E_F - E_D}{K_B T})}$$

电离受主浓度 p_A^-

$$p_A^- = N_A - p_A = N_A [1 - f_A(E)] = \frac{N_A}{1 + 2 \exp(\frac{E_A - E_B}{K_B T})}$$

3. 杂质能级与杂质电离程度

杂质能级与费米能级相对位置能 反映电子和空穴占据杂质能级的情况

对施主 $E_D - E_F \square K_B T$ 费米能级远在 E_D 之下 全电离

 $E_D - E_F \square K_B T$ 费米能级远在 E_D 之上 未电离

 $E_D - E_F = K_B T$ 电离1/3,未电离2/3

对受主 $E_F - E_A \square K_B T$ 费米能级远在 E_A 之上 全电离

 $E_F - E_A \square K_B T$ 费米能级远在 E_A 之下 未电离

 $E_F - E_A = K_B T$ 电离1/3,未电离2/3

七、n型半导体的载流子浓度

电中性条件:
$$n_0 = n_D^+ + p_0$$

 导带中电子浓度 施主电离浓度 价带中空穴浓度

$$N_{c} \exp(-\frac{E_{C} - E_{F}}{K_{B}T}) = N_{v} \exp(-\frac{E_{F} - E_{C}}{K_{B}T}) + \frac{N_{D}}{1 + 2 \exp(-\frac{E_{D} - E_{F}}{K_{B}T})}$$

电离过程: 低温时,杂质电离

T↑,杂质全电离,无本征激发

T↑,本征激发开始

T↑,本征激发强烈

1、低温弱电离区

1) E_F位置

电中性条件 $n_0 = n_D^+$

$$N_{C} \exp(-\frac{E_{C} - E_{F}}{K_{B}T}) = \frac{N_{D}}{1 + 2 \exp(-\frac{E_{D} - E_{F}}{K_{B}T})}$$

温度很低时 n_D << N_D

$$N_{C} \exp\left(-\frac{E_{C} - E_{F}}{K_{B}T}\right) = \frac{1}{2} N_{D} \exp\left(\frac{E_{D} - E_{F}}{K_{B}T}\right)$$

$$E_{F} = \frac{E_{C} + E_{D}}{2} + \left(\frac{K_{B}T}{2}\right) \ell n \left(\frac{N_{D}}{2N_{C}}\right)$$

$$\lim_{T \to 0K} E_{F} = \frac{E_{C} + E_{D}}{2}$$

$$\lim_{T \to 0K} (T \ln T) = 0$$

低温极限、只有施主杂质n型半导体, E_F 位于 E_C ~ E_D 中线处。

2) E_F位置的变化

$$N_c = 2(\frac{m_n^* K_B T}{2\pi \hbar^2})^{\frac{3}{2}}$$

$\frac{dE_F}{dT} = \frac{K_B}{2} \ln(\frac{N_D}{2N_c}) + \frac{K_B T}{2} \frac{d}{dT} (-\ln 2N_C) = \frac{K_B}{2} \left[\ln(\frac{N_D}{2N_c}) - \frac{3}{2} \right]$						
T	N_{C}	$\mathrm{d}E_{\scriptscriptstyle F}/\mathrm{d}T$	$E_{\scriptscriptstyle F}$			
→0K	→ 0	$\rightarrow +\infty$	上升很快			
↑	↑	\downarrow	随T升高而增大,但速度变小			
↑	$N_C = (N_D/2)e^{-3/2}$ = 0.11 N_D	0	上升到极大值			
↑	$-0.11IV_D$	<0	下降			
↑	$N_C = 0.5N_D$	<0	回到E _C ~E _D 中线			
↑	$N_C > 0.5 N_D$	<0	低于中线。E _F =E _{C,} 1/3电离			

杂质含量越高, E_F 达到极大值的温度也越高

- 2、强电离区(全电离、饱和电离)
- 一方面杂质已基本上电离,另一方面本征激发不太明显,

电中性条件
$$n_0 = N_D$$

$$E_F = E_C + K_B T ln(\frac{N_D}{N_C})$$

一般掺杂浓度下 $N_C > N_D$ T一定, N_D 越大, E_F 越向导带方向靠近, N_D 一定, T越高, E_F 越向本征费米能级靠近

3、高温过渡区

导带中的电子一部分来源于全部电离的杂质,

 $n_0 = n_i \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{K_B T}\right)$

电中性条件 $n_0 = N_D + p_0$

$$n_0 = N_D + p_0$$

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{K_B T}\right)$$

$$N_D = n_0 - p_0 = n_i \left[\exp\left(-\frac{E_i - E_F}{K_B T}\right) - \exp\left(\frac{E_i - E_F}{K_B T}\right) \right] = 2n_i \operatorname{sh}\left(\frac{E_F - E_i}{K_B T}\right)$$

$$E_F = E_i + K_B T [\sinh^{-1} (N_D / 2n_i)]$$

$$N_{\scriptscriptstyle D}/2n_{\scriptscriptstyle i}$$
 很小时 $E_{\scriptscriptstyle F}-E_{\scriptscriptstyle i}$ 也很小, $E_{\scriptscriptstyle F}$ 接近于 $E_{\scriptscriptstyle i}$

$$N_D/2n_i$$
 增大时 E_F-E_i 增大, E_F 接近饱和区

$$n_0 = \frac{N_D}{2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right]$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \left(\frac{2n_i^2}{N_D}\right) \left[1 + \left(1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{-1}$$

近杂质饱和电离区

$$N_D \square n_i$$

$$n_0 = N_D + \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$p_0 = n_0 - N_D = \frac{n_i^2}{N_D}$$

n型半导体的电子浓度比空穴浓度大得多, 电子称为多数载流子,简称多子; 空穴称为少数载流子,简称少子

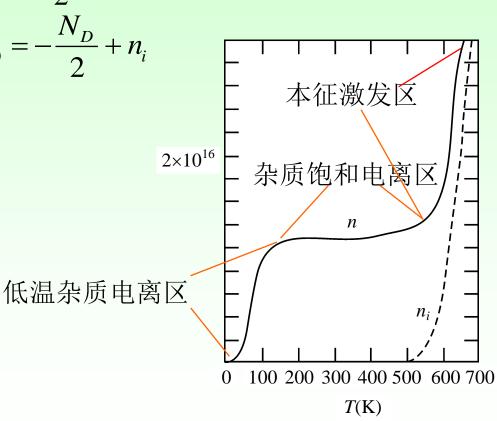
近本征激发区

$$N_D \ll n_i$$

$$n_0 = \frac{N_D}{2} + n_i$$

$$p_0 = -\frac{N_D}{2} + n_i$$

更接近本征激发区 杂质浓度超高,达到 本征激发起主要作用 的温度也越高



4、高温本征区

$$N_D << n_i$$

$$n_0 \square N_D \qquad p_0 \square N_D$$

$$n_0 = p_0$$

E_F在禁带中心 杂质浓度越高,达到本征激发起主要作用的温度也越高

p型半导体的载流子浓度讨论类似,公式见书

第四节 简并半导体

掺杂浓度低 $N_D < N_C N_A < N_V$ 轻掺杂

费米能级处于禁带中

用玻耳兹曼函数分析载流子分布

非简并半导体

掺杂浓度很高

 $N_D \geqslant N_C \qquad N_A \geqslant N_V$

重掺杂

费米能级与导带底或价带顶重合, 甚至进入导带或价带

用费米函数分析载流子分布载流子的简并化

简并半导体

一、简并半导体的载流子浓度

$$n_{0} = \frac{\left(2m_{n}^{*}\right)^{3/2}}{2\pi^{2}\hbar^{3}} \int_{E_{C}}^{\infty} \frac{\left(E - E_{C}\right)^{1/2}}{1 + \exp\left(\frac{E - E_{F}}{K_{B}T}\right)} dE$$

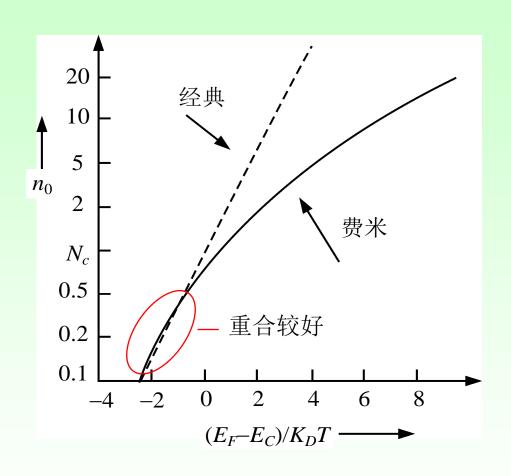
费米积分
$$F_{1/2}(\xi) = F_{1/2}\left(\frac{E_F - E_C}{K_B T}\right)$$

$$n_0 = N_C \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{1/2} \left(\frac{E_F - E_C}{K_B T} \right)$$

$$p_{0} = N_{V} \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{1/2} \left(\frac{E_{V} - E_{F}}{K_{B} T} \right)$$

二、简并化条件

$$E_C - E_F > 2K_B T$$
 非简并 $0 < E_C - E_F \le 2K_B T$ 弱简并 $E_C - E_F \le 0$ 简并



三、简并时的杂质浓度

n型半导体,杂质激发的温度范围

电中性条件
$$n_0 = n_D^+$$
 $N_C \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{1/2} \left(\frac{E_F - E_C}{K_B T} \right) = \frac{N_D}{1 + 2 \exp\left(\frac{E_F - E_D}{K_B T} \right)}$

$$N_D = \frac{2N_C}{\sqrt{\pi}} \left[1 + 2 \exp\left(\frac{\Delta E_D}{K_B T} \right) \right] F_{1/2} (0) \qquad F_{1/2} \left(0 \right) = 0.6$$

$$N_D = 0.68 N_C \left[1 + 2 \exp\left(\frac{\Delta E_D}{K_B T} \right) \right] \qquad \qquad$$
最小值为3

结论: 发生简并时

 N_D 接近或大于 N_C

杂质电离能越小,则杂质浓度较小时就会发生简并。

四、杂质带导电

杂质原 被杂质原子束缚 杂质 杂质 浓度 电子共有化运动 能级 子间距 禁带中 远 非简并 低 无 独立 能带 有 简并 高 近 (杂质能带)

